苏州东微半导体股份有限公司 2021 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以苏州东微半导体股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度报告披露为准,提请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
			(%)
营业总收入	78, 209. 18	30, 878. 74	153. 28
营业利润	16, 876. 17	3, 267. 74	416.45
利润总额	16, 876. 18	3, 245. 08	420.05
归属于母公司所有	14, 647. 73	2, 768. 32	429. 12
者的净利润			
归属于母公司所有			
者的扣除非经常性	14, 008. 06	2, 040. 26	586. 58
损益的净利润			
基本每股收益 (元)	2.90	0.60	383.33
加权平均净资产收	29.76%	12.66%	增加 17.1 个

益率			百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
			(%)
总 资 产	62, 814. 64	43, 764. 02	43. 53
归属于母公司的所	56, 536. 73	41, 889. 80	34. 97
有者权益			
股 本	5, 053. 23	5, 053. 23	-
归属于母公司所有			
者的每股净资产	11. 19	8. 29	34. 98
(元)			

- 注: 1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。
 - 2. 上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。
- 3. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司 2021 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

- (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
- 1、报告期的经营情况、财务状况

2021 年度公司经营情况良好,实现营业收入 78,209.18 万元,同比增长 153.28%;实现归属于母公司所有者的净利润 14,647.73 万元,同比增长 429.12%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 14,008.06 万元,同比增长 586.58%。报告期末,公司总资产 62,814.64 万元,较报告期初增长 43.53%;归属于母公司的所有者权益 56,536.73 万元,较报告期初增长 34.97%。

2、影响经营业绩的主要因素

2021 年度,公司所在的半导体功率器件领域景气度持续向好,下游需求旺盛,同时,公司通过不断深化与上下游优秀合作伙伴的合作,持续扩大产能,并

不断研发出更为优秀的产品与技术。公司主要产品包括高压超级结 MOSFET、中低压屏蔽栅 MOSFET、超级硅 MOSFET、IGBT 产品,广泛应用于新能源汽车充电桩、通信电源、光伏逆变器、新能源车车载充电机、数据中心服务器电源、快速充电器等领域。报告期内,公司业绩的持续增长主要系受前述应用领域需求增长、产能持续扩大、新产品不断推出及产品组合结构进一步优化等因素影响。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

- 1、2021 年度公司营业收入同比增长 153.28%, 主要系受益于新能源汽车充电桩、通信电源、光伏逆变器等终端市场需求快速提升, 客户对公司的采购规模增长所致。
- 2、2021 年度营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比分别增长416.45%、420.05%、429.12%、586.58%、383.33%,增幅均高于同期营业收入增幅,主要系 2021 年度毛利率较去年同期大幅上涨所致,2021 年度公司毛利率较去年同比上涨 11.02 个百分点。
- 3、2021 年度总资产同比增长 43.53%, 主要由于报告期内伴随着公司业务的不断开展, 货币资金、预付款项、应收账款、存货等科目增长所致。
- 4、2021 年度归属于母公司的所有者权益、归属于母公司所有者的每股净资产分别同比增长 34.97%、34.98%,主要由于报告期内公司盈利能力不断提升所致。

三、风险提示

本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,相关数据可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准。提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一)经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人 (会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会 2022 年 02 月 25 日